



Tagesordnung

Thema: 62. Treffen des Arbeitskreises
„Systemzuverlässigkeit von Aufbau- und
Verbindungstechnologien“

Datum: **Mittwoch, 14. Februar 2018, 10.00 Uhr**

Ort: Fraunhofer IZM, Berlin

Teilnehmer: AK-Mitglieder, Referenten

Tagesordnungspunkte

- 1 10:00 Uhr
Begrüßung, Erläuterung zur Tagesordnung
Herr Wüst, Fraunhofer IZM, Berlin
- 2 10:10 Uhr
Analytische Bewertung von niederohmigen Verbindungen in der inneren
Struktur von Multilayer-Leiterplatten
Herr Bruderreck, TechnoLab GmbH, Berlin
- 3 11:10 Uhr
A MEMS-based approach for contact normal force measurement in crimp
terminals
Herr Dr. Majcherek, TEPROSA GmbH, Magdeburg
- 4 11:50 Uhr
Erzeugung leitfähiger Strukturen auf 3D-Kunststoffsubstraten mittels Laser-
Pulverauftragsschweißens
Herr Hentschel, Uni Erlangen, Erlangen
- 5 12:30 Uhr
Mittagessen

- 6 13:30 Uhr
Reliability and quality improvement of power semiconductor devices
Herr Sulyok, Mentor Graphics,
- 7 14:10 Uhr
Untersuchung von beschichteten Kontaktgeometrien für Steckverbinder
Herr Dyck, WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG,
- 8 14:50 Uhr
Kaffeepause
- 9 15:00 Uhr
N.N.
N.N. , ,
- 10 15:40 Uhr
Stress-Sensoren zur Prozesscharakterisierung
Herr Dobs, Fraunhofer IZM, Berlin
- 11 16:20 Uhr
Abschlussdiskussion
Herr Wüst, Fraunhofer IZM, Berlin

Ende der Veranstaltung gegen 16:30 Uhr